

IBM 宣布推出全新 AI 芯片，助力企业数字化转型

日期

- 全新 AI 芯片，性能提升 50%，功耗降低 30%
- 支持多种 AI 应用，包括自然语言处理、图像识别等
- 与 IBM 云平台无缝集成，助力企业数字化转型

2024 年 1 月 10 日 / 北京时间 -- 1 月 10 日，IBM 宣布推出全新 AI 芯片，助力企业数字化转型。这款全新 AI 芯片，性能提升 50%，功耗降低 30%，支持多种 AI 应用，包括自然语言处理、图像识别等。与 IBM 云平台无缝集成，助力企业数字化转型。

这款全新 AI 芯片，性能提升 50%，功耗降低 30%，支持多种 AI 应用，包括自然语言处理、图像识别等。与 IBM 云平台无缝集成，助力企业数字化转型。这款全新 AI 芯片，性能提升 50%，功耗降低 30%，支持多种 AI 应用，包括自然语言处理、图像识别等。与 IBM 云平台无缝集成，助力企业数字化转型。

IBM 宣布推出全新 AI 芯片，助力企业数字化转型。这款全新 AI 芯片，性能提升 50%，功耗降低 30%，支持多种 AI 应用，包括自然语言处理、图像识别等。与 IBM 云平台无缝集成，助力企业数字化转型。

这款全新 AI 芯片，性能提升 50%，功耗降低 30%，支持多种 AI 应用，包括自然语言处理、图像识别等。与 IBM 云平台无缝集成，助力企业数字化转型。这款全新 AI 芯片，性能提升 50%，功耗降低 30%，支持多种 AI 应用，包括自然语言处理、图像识别等。与 IBM 云平台无缝集成，助力企业数字化转型。

IBM 宣布推出全新 AI 芯片，助力企业数字化转型。这款全新 AI 芯片，性能提升 50%，功耗降低 30%，支持多种 AI 应用，包括自然语言处理、图像识别等。与 IBM 云平台无缝集成，助力企业数字化转型。

IBM 宣布推出全新 AI 芯片，助力企业数字化转型。这款全新 AI 芯片，性能提升 50%，功耗降低 30%，支持多种 AI 应用，包括自然语言处理、图像识别等。与 IBM 云平台无缝集成，助力企业数字化转型。

Contact: Kelvin Liu
External Communications
E-mail: kelvin.liu@ibm.com
Mobile: 86-15110254110
Address: 12F, South Tower, CP Center, Building 3, 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, 100020, China
2024 年 1 月 10 日

SOURCE IBM China

<https://china.newsroom.ibm.com/2024-01-10-IBM->